



TIC® 800D 系列是一种具高热传导性与高介电常数的绝缘垫片，采用聚酰亚胺薄膜为基材，表面涂覆含陶瓷混合填料的低熔点相变材料。当温度达到 50°C 时，材料表面开始软化并流动，有效填充散热片与积体电路板之间的微小不规则间隙，从而降低热阻、提升导热效率。

特性

- 》表面较柔软, 良好的导热率
- 》良好电介质强度
- 》高压绝缘, 低热阻
- 》抗撕裂, 抗穿刺

应用

- 》功率半导体器件, MOSFETs 及 IGBTs
- 》视听产品
- 》汽车控制装置
- 》电动机控制设备

TIC® 800D 系列特性表		
产品特性	典型值	测试方法
颜色	淡琥珀色	目视
复合厚度	0.004"/0.102 mm	ASTM D374
聚酰亚胺薄膜厚度	0.001"/0.025 mm	ASTM D374
总厚度	0.005"/0.127 mm	ASTM D374
拉伸强度 (Mpa)	17	ASTM D412
建议使用温度范围 (°C)	-50~130	兆科测试
相变温度 (°C)	50~60	-
电性		
击穿电压 (VAC)	5000	ASTM D149
介电常数@1MHz	1.8	ASTM D150
体积电阻率 (Ohm·m)	1.0×10^{12}	ASTM D257
导热性		
导热率 (W/mK)	1.6	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in²/W) @50psi	0.16	ASTM D5470

产品规格

标准厚度:

0.005" (0.127 mm), 如需不同厚度请与本公司联系。

标准尺寸:

10" x 100" (254 mm x 30 m), 可模切成不同形状提供。

压敏黏合剂:

压敏黏合剂不适用于TIC®800D 系列产品。

补强材料:

TIC®800D 系列以聚酰亚胺薄膜为补强。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208

台湾: +886-2-2277-1007

加拿大: +001-604-2998559

越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。



TIC800D-0525